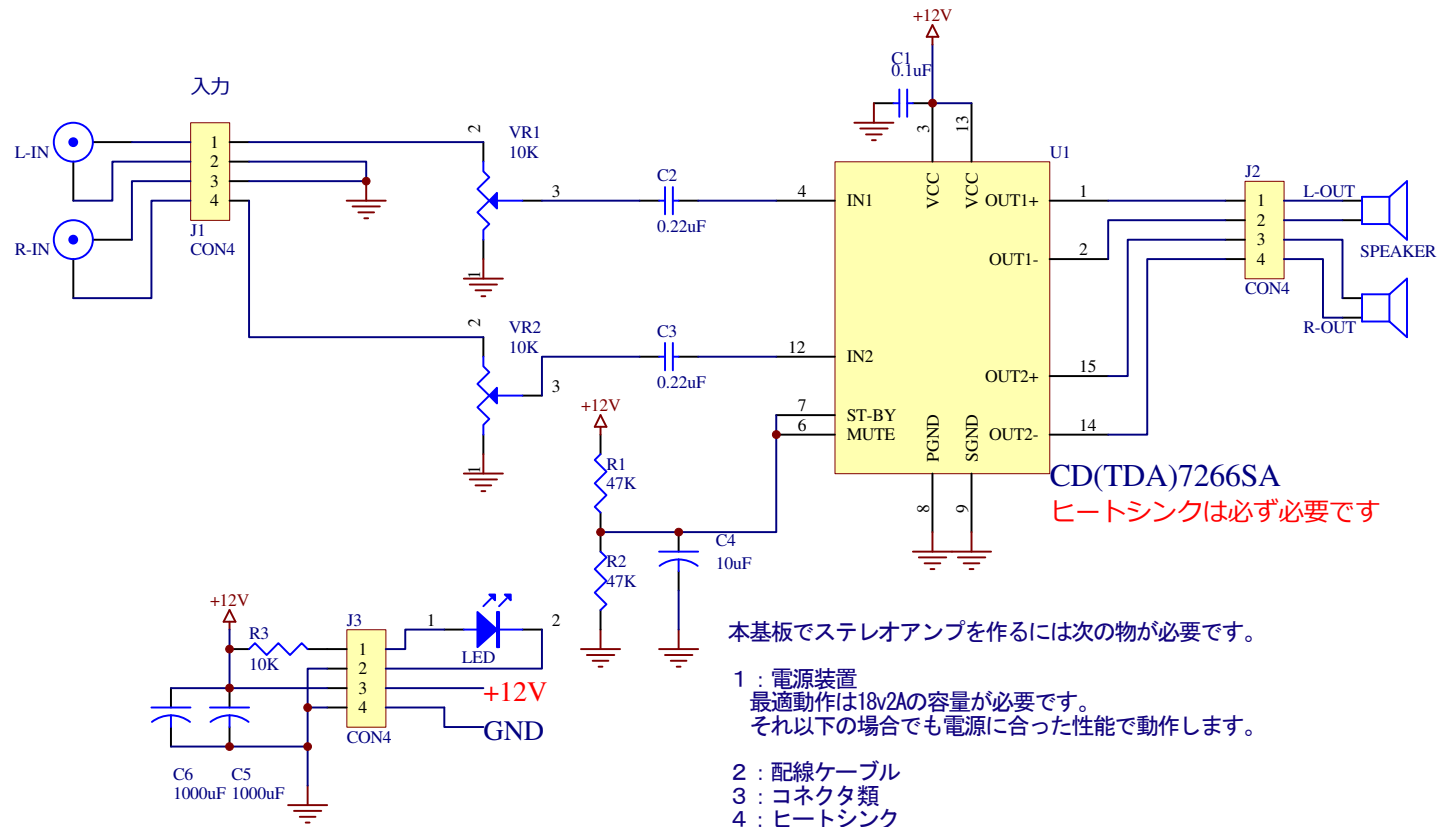


作り方

- 0 : ICの取り付け（半田付け）は最後に行います。
 1 : 背の低い順に実装、半田付けを行います。
 2 : 四角いランドは1番ピンを示します。
 3 : ケミカルコンデンサに极性があります。ご注意ください。
 4 : ICの取り付けは放熱板の位置、シャーシの高さなどを考慮し位置を確認してから半田付けしてください。
 5 : ICには必ずヒートシンクをつけて電源を入れてください。手元にヒートシンクが無い場合、空き缶で簡易ヒートシンクを作る事が出来ます。また、金属ケースをヒートシンクとしても良い
 6 : 電源は音量にもよりますが最低電圧は3V、最高は18V 高出力の場合、12V2A以上の電源を相用意ください。

部品表

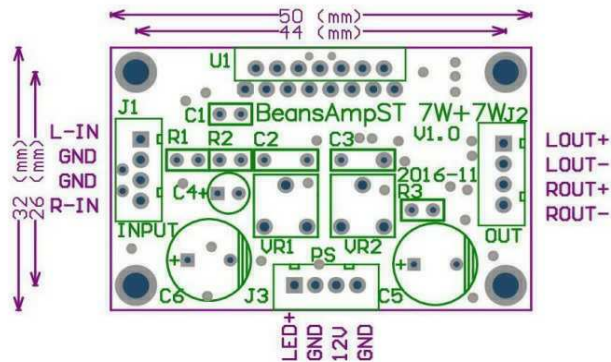
Used Part	Type	Designator
1	0.1uF	C1
2	0.22uF	C2 C3
2	1000uF	C5 C6
1	10K	VR1 VR2
1	10uF	C4
2	47K	R1 R2
1	10K	R3
1	CD (TDA) 7266SA	U1



CD(TDA)7266SA
 ヒートシンクは必ず必要です

本基板でステレオアンプを作るには次の物がが必要です。

- 1 : 電源装置
 最適動作は18V2Aの容量が必要です。
 それ以下の場合でも電源に合った性能で動作します。
- 2 : 配線ケーブル
- 3 : コネクタ類
- 4 : ヒートシンク
- 5 : ケース
- 6 : ねじ等
- 7 : コネクタ、圧着済み配線ケーブル、RCAコネクタ、スピーカー端子等を合わせたオプション部品セットを別売で用意する予定です（ケース、電源、取付ねじを除く）



合資会社エフエーエル		BeansAmpST		CD(TDA)7266SA 7W+7Wステレオアンプ基板回路図	
		Size A4	FCSM No.	DWG No.	Rev
Scale		Sheet 0 of 0			